

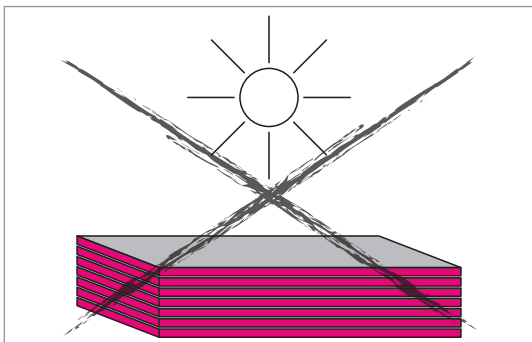


Verwerkingsinstructies Wandtoepassing

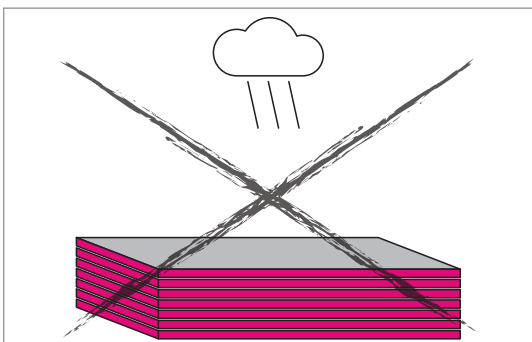
Inhoudsopgave

A	Algemene instructies	Pagina 3
B	Toepassingsgebieden	
	B.1 Verwerking op een egale en niet-hechtende ondergrond	Pagina 4
	B.2 Verwerking op een oneffen ondergrond	Pagina 5
	B.3 Verwerking op een egale en hechtende ondergrond	Pagina 6
	B.4 Verwerking op een regelwerk	Pagina 7
	B.5 Verwerking als scheidingswand	Pagina 8
C	Wapeningsband/afdichtingsband	Pagina 9
D	Betegelen/bepleisteren	
	D.1 Betegelen	Pagina 10
	D.2 Bepleisteren	Pagina 10
E	Bevestiging van voorwerpen	Pagina 11
F	Verklaringen	Pagina 12

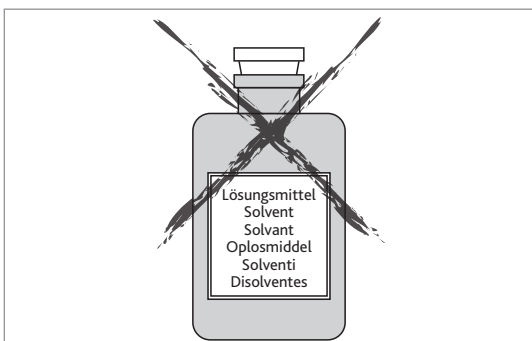
A.1



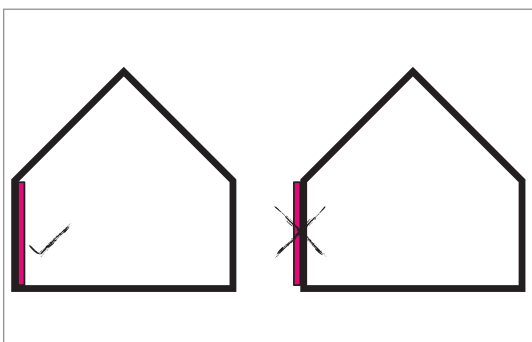
A.2



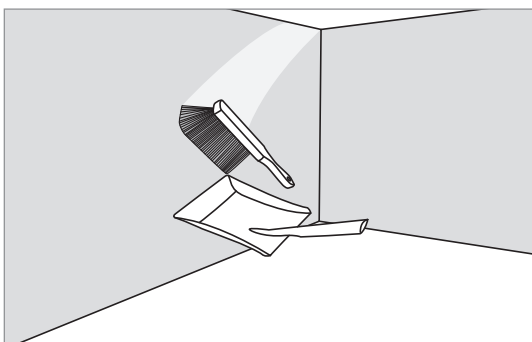
A.3



A.4



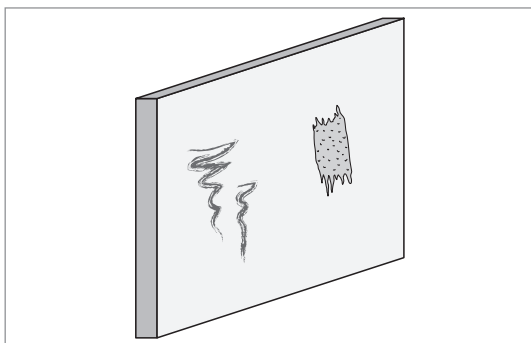
A.5



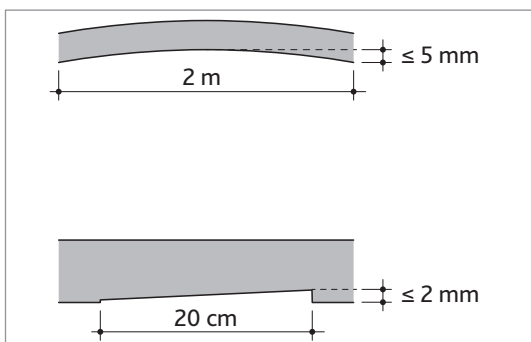
B Toepassingsgebieden

B.1 Verwerking op een egale en niet-hechtende ondergrond

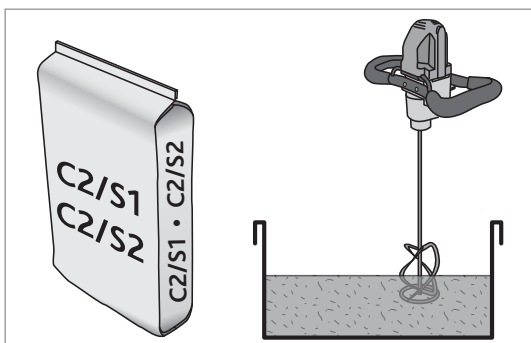
B.1.1



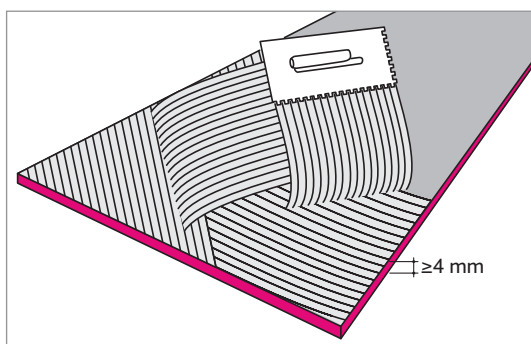
B.1.2



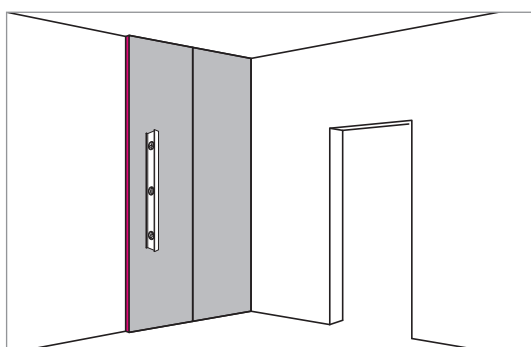
B.1.3



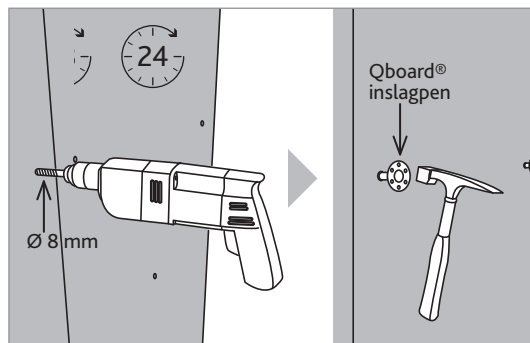
B.1.4



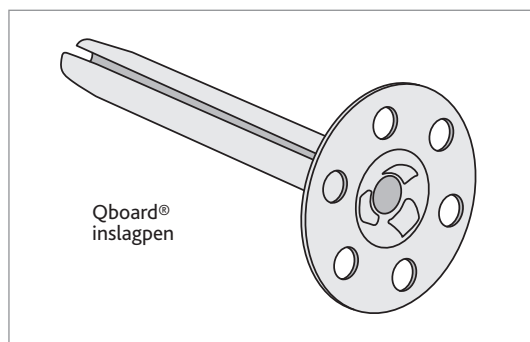
B.1.5



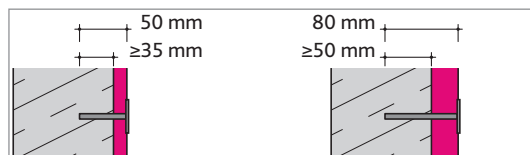
B.1.6



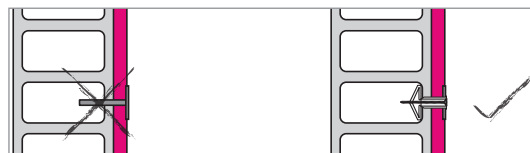
B.1.7



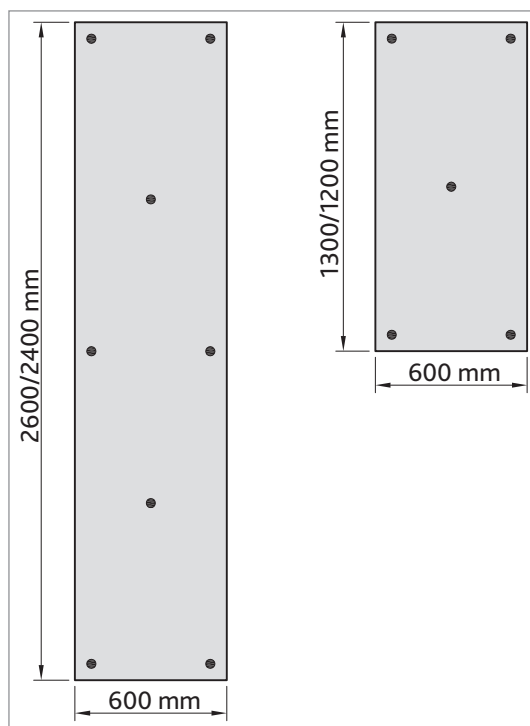
B.1.8



B.1.9

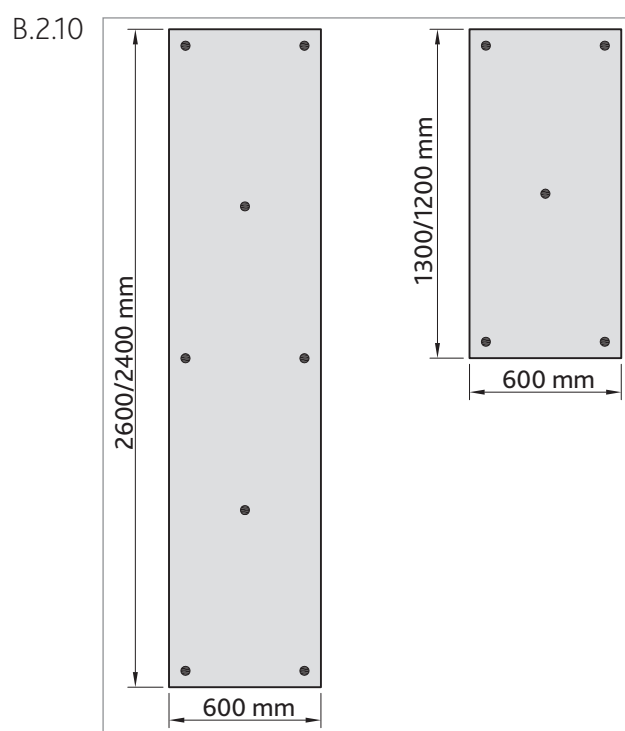
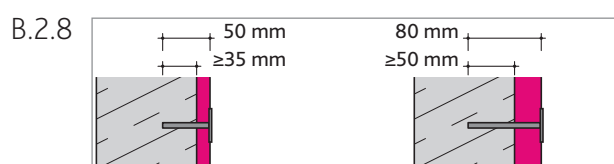
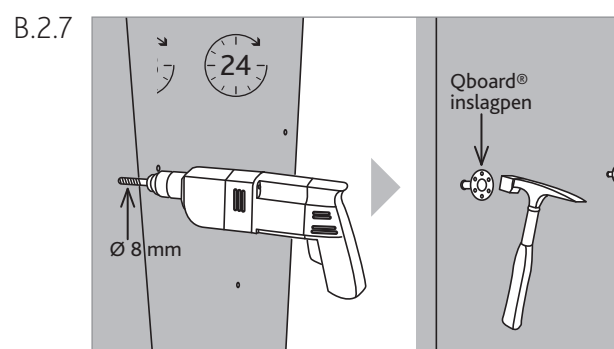
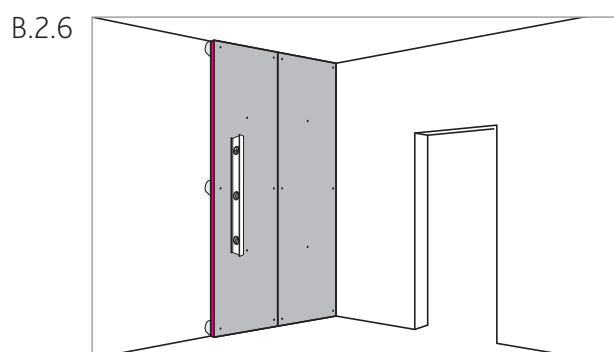
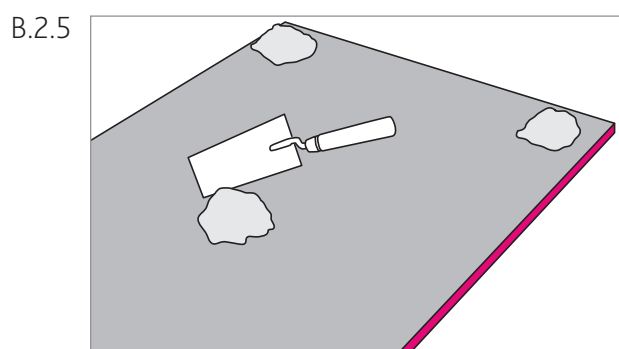
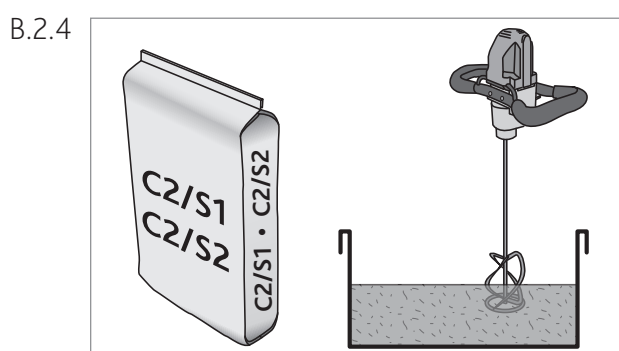
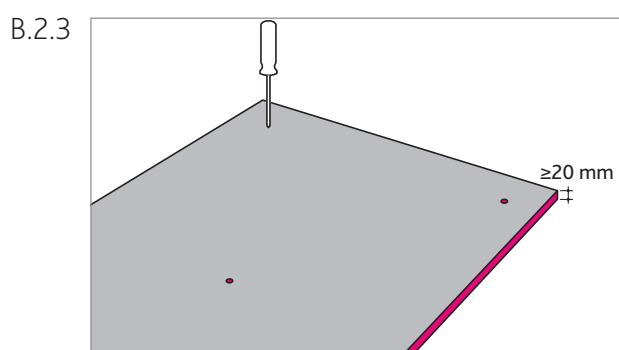
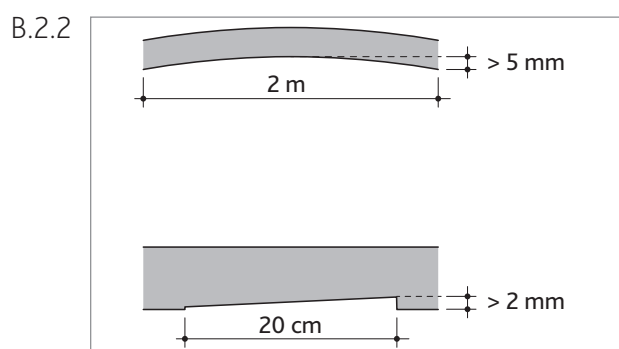
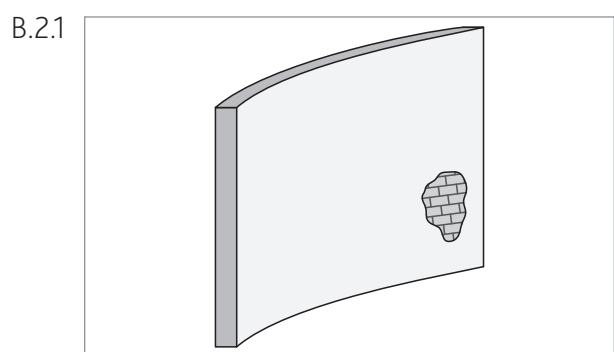


B.1.10



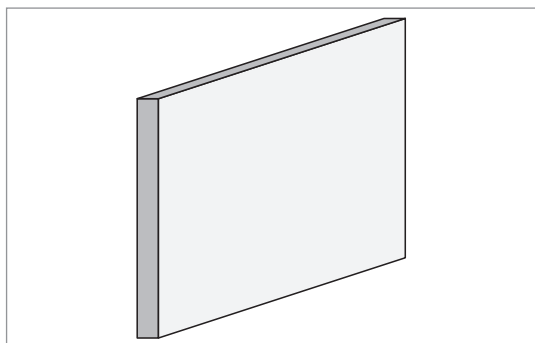
B Toepassingsgebieden

B.2 Verwerking op een oneffen ondergrond

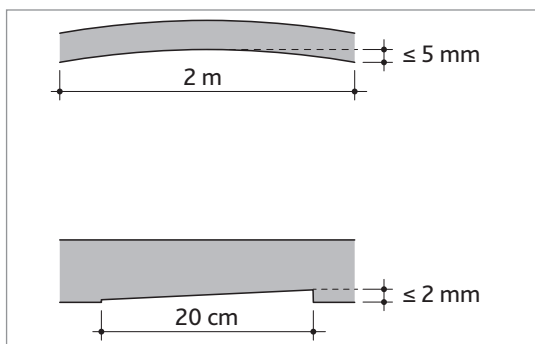


B Toepassingsgebieden

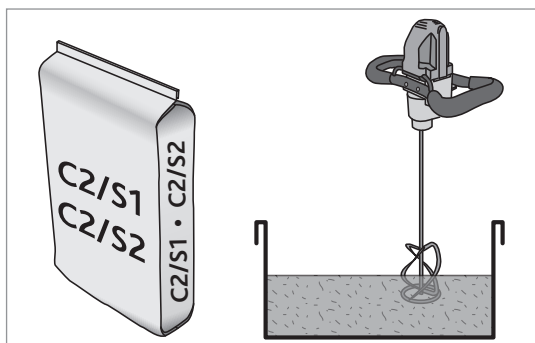
B.3 Verwerking op een egale en hechtende ondergrond



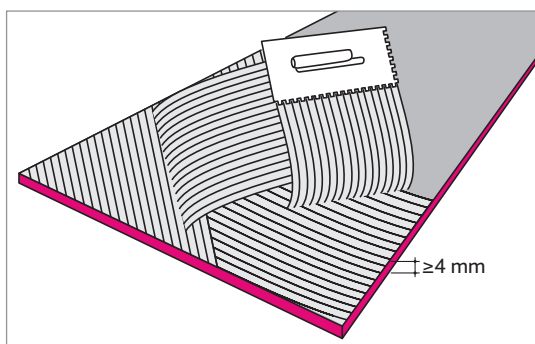
B.3.1



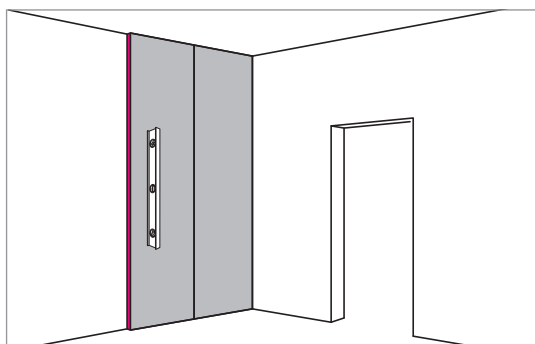
B.3.2



B.3.3



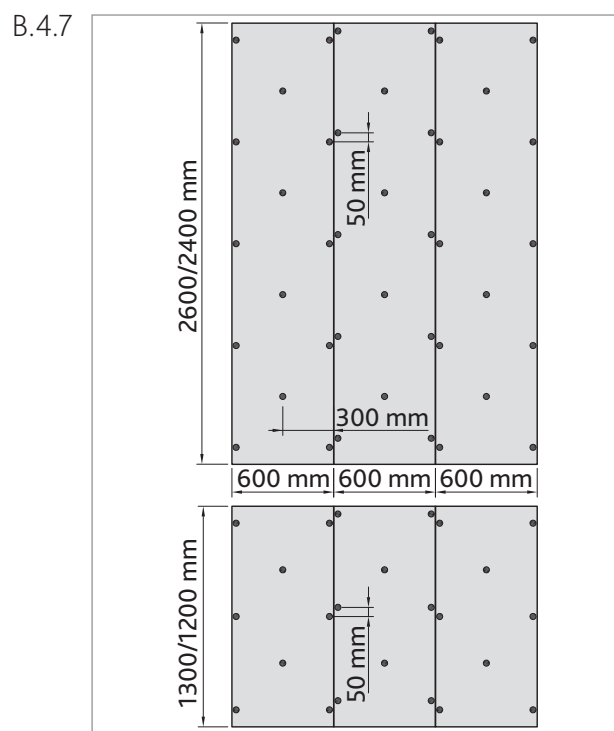
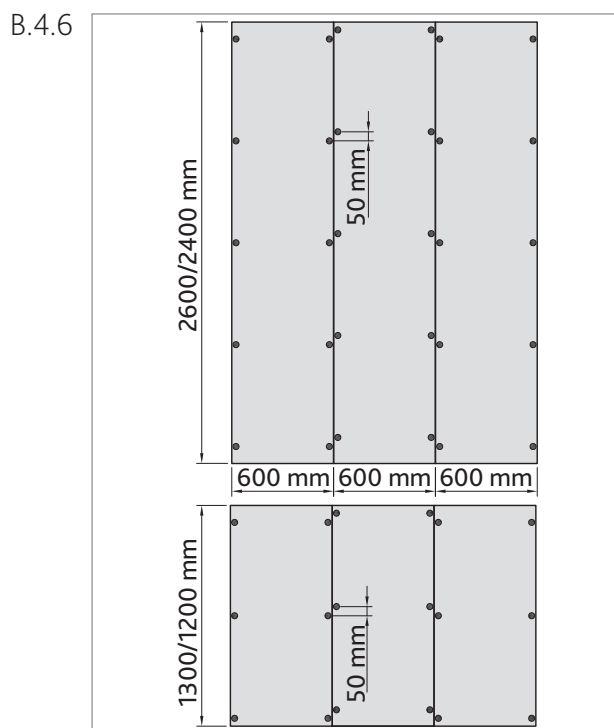
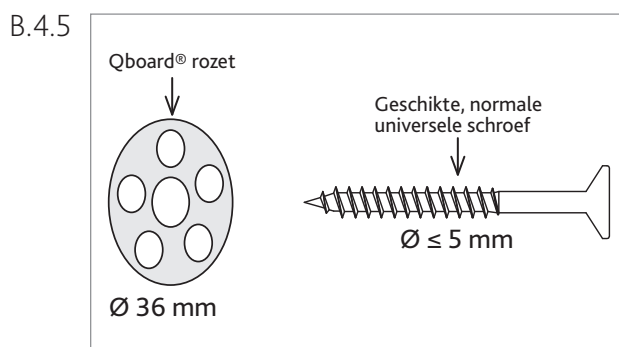
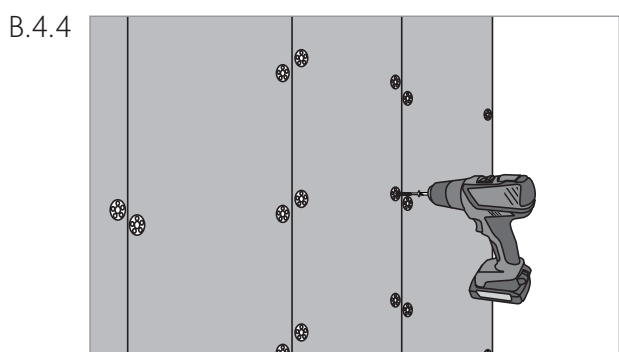
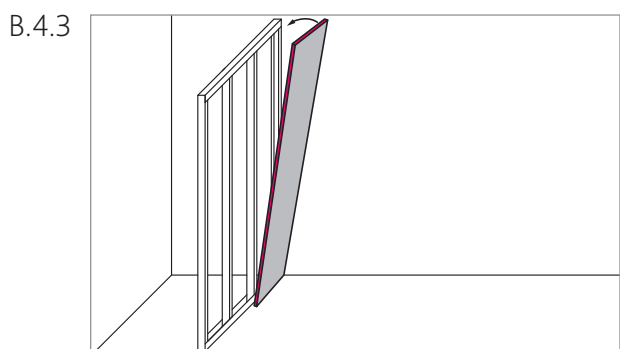
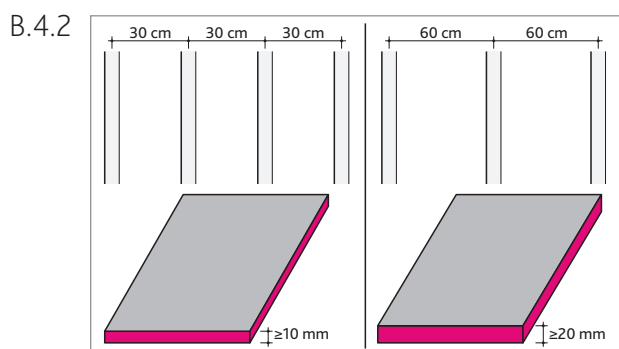
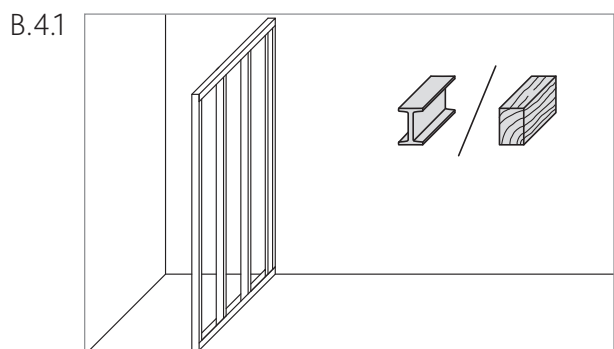
B.3.4



B.3.5

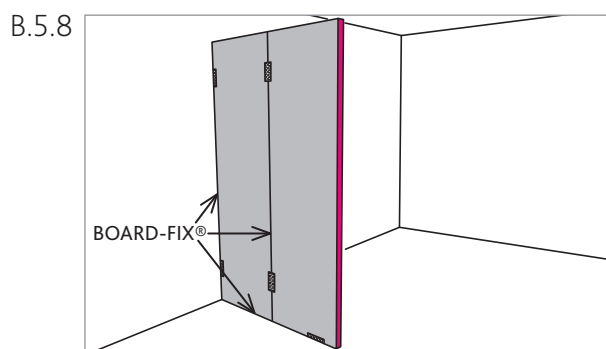
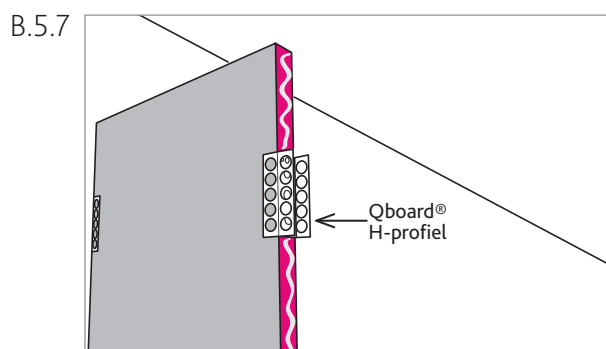
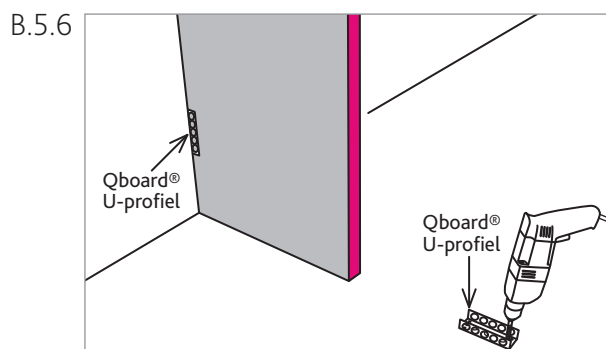
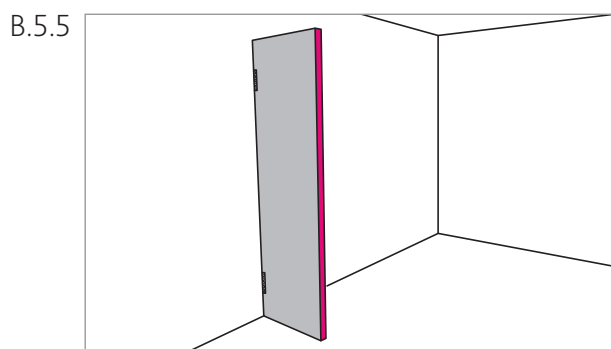
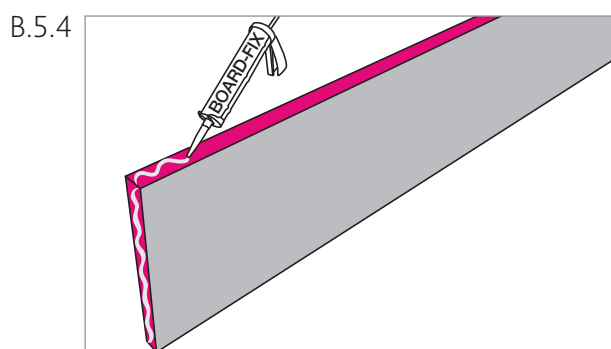
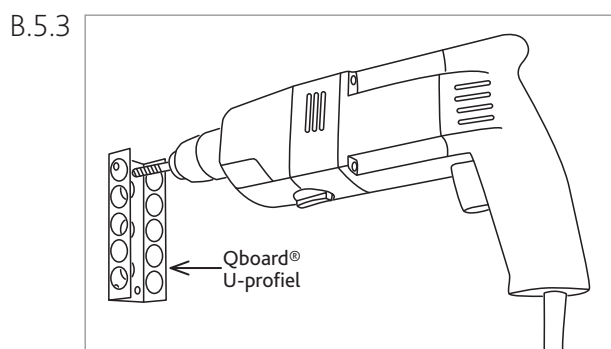
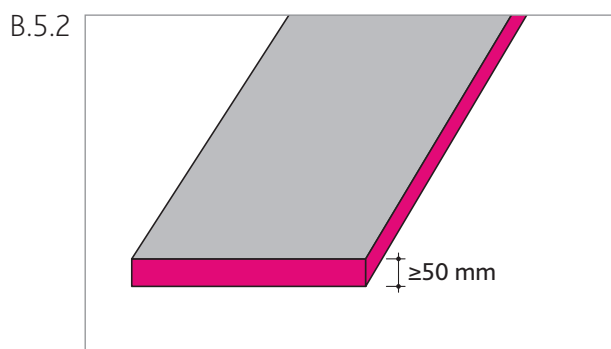
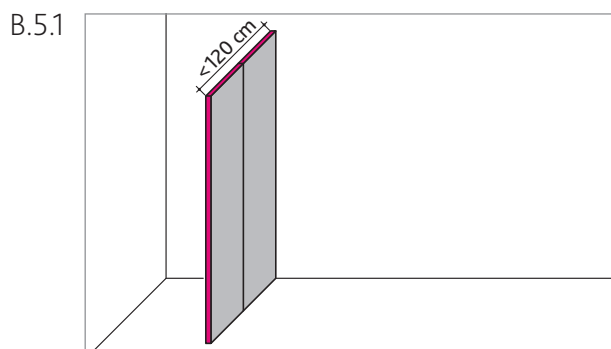
B Toepassingsgebieden

B.4 Verwerking op een regelwerk



B Toepassingsgebieden

B.5 Verwerking als scheidingswand



C Wapeningsband/afdichtingsband

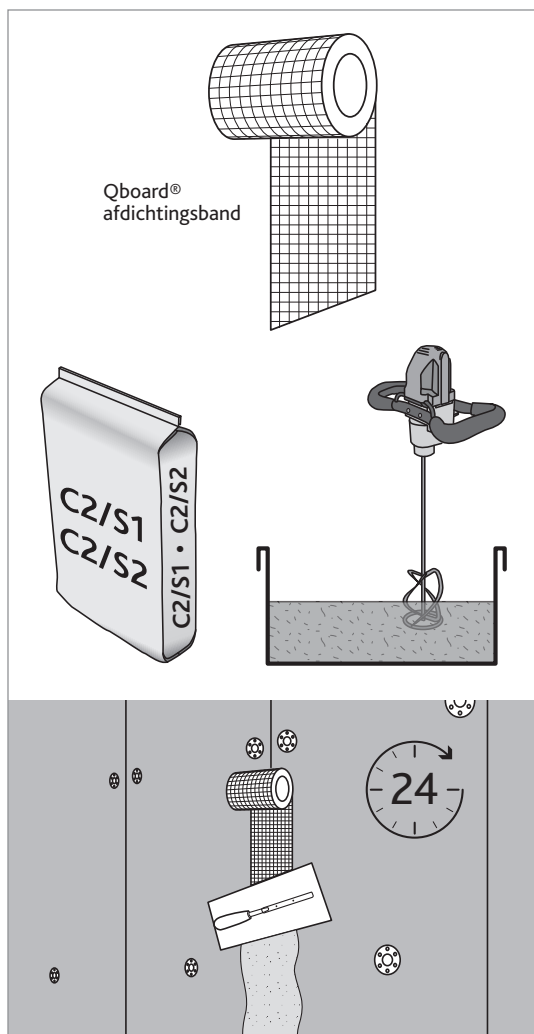
C.1



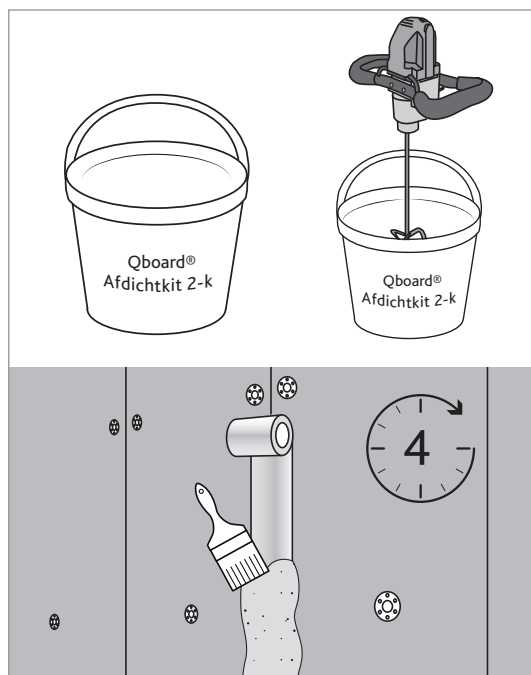
C.2



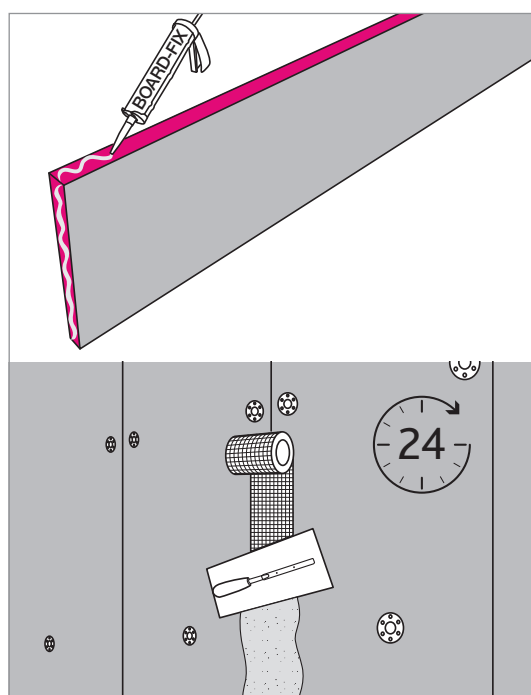
C.1.1



C.2.1.



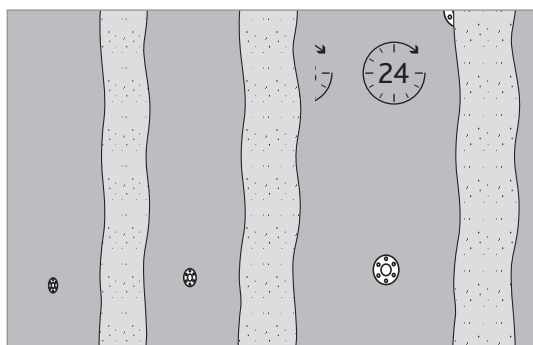
C.2.2.



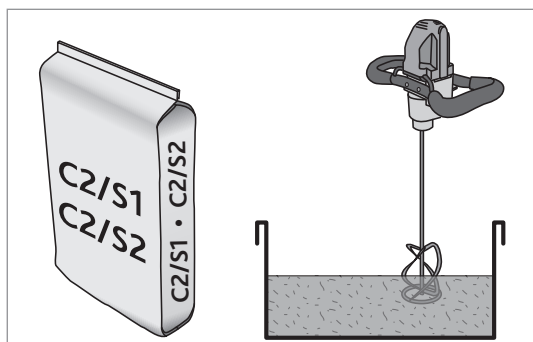
D Betegelen/bepleisteren

D.1 Betegelen

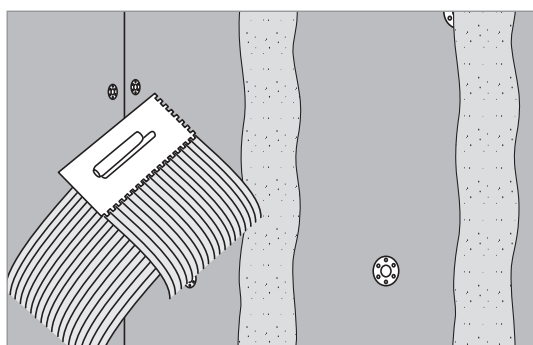
D.1.1



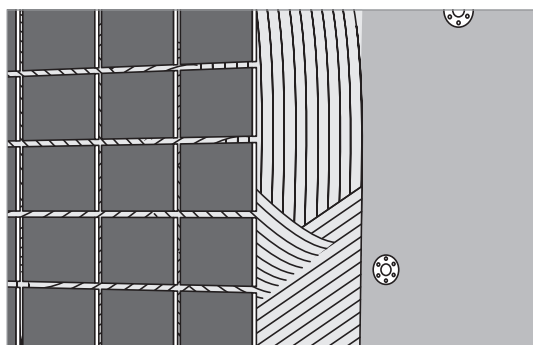
D.1.2



D.1.3

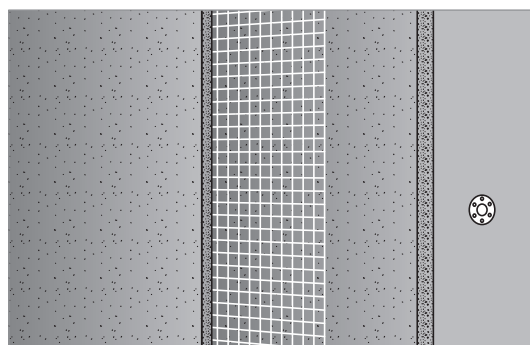


D.1.4

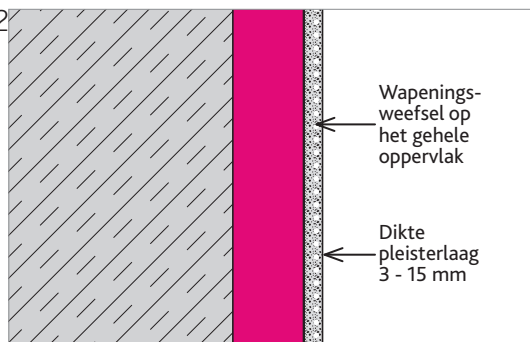


D.2 Bepleisteren

D.2.1



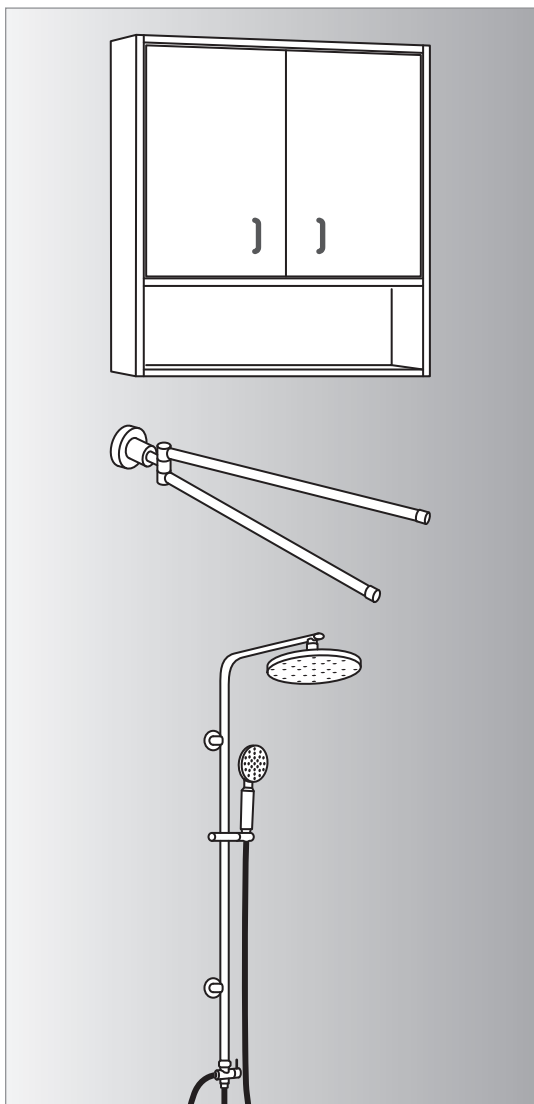
D.2.2



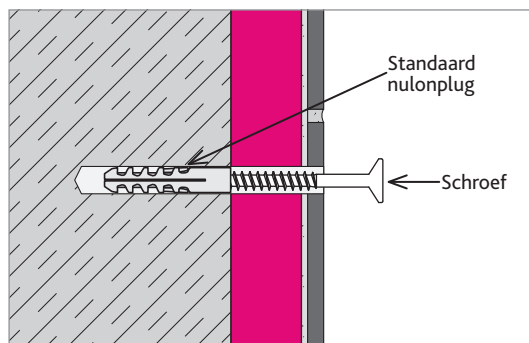
E Bevestiging van voorwerpen

E.1 Bevestiging boven 5 kg

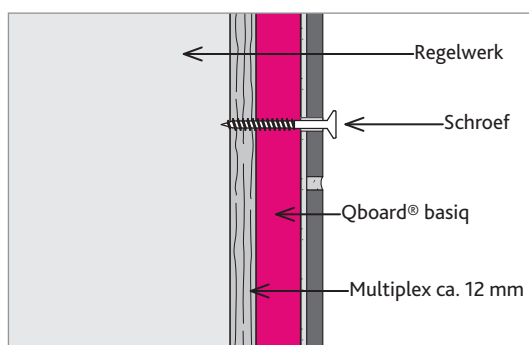
E.1.1



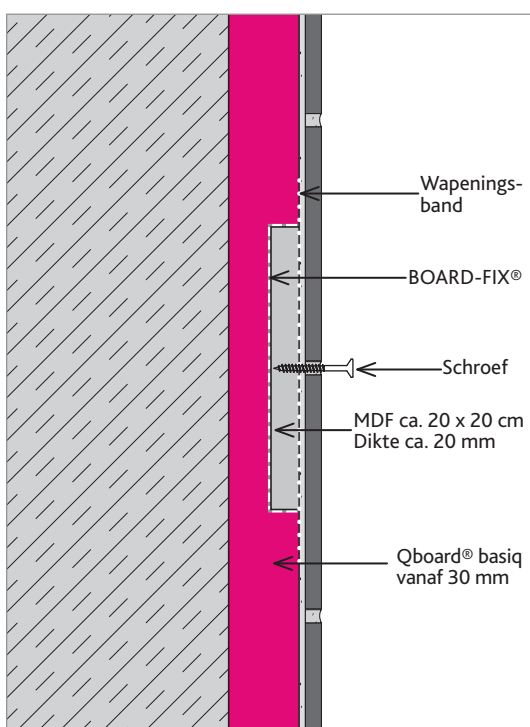
E.1.3



E.1.4

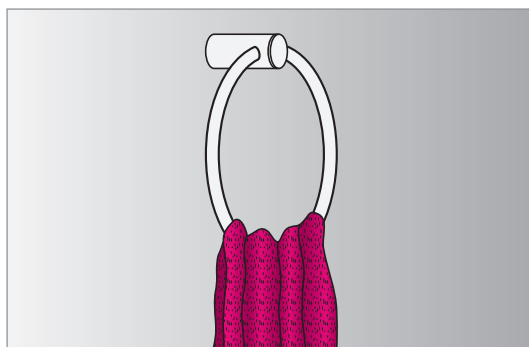


E.1.2

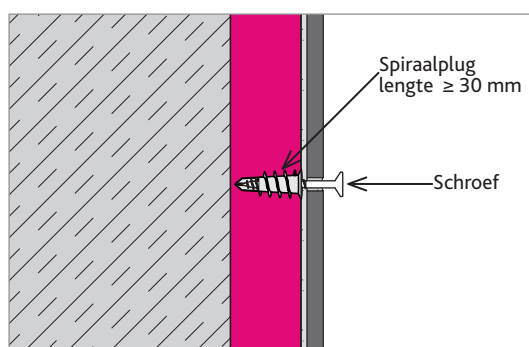


E.2 Bevestiging tot 5 kg

E.2.1



E.2.2



A Algemene instructies

Toepassingsgebied

Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van Qboard® basiq bouw- en tegelementen als tegel- en plaatdragers voor binnen. Er worden tips gegeven voor de planning en uitvoering bij gewone toepassingen in de woning-, utiliteits- en industriebouw.

De aanbevelingen gelden uitsluitend voor toepassingen in ruimtes met normale temperaturen.

Bij gebruik van het bouw- en tegelement voor speciale toepassingen, bijv. in zwembaden, koelcellen enz., dient altijd overleg met de fabrikant te worden gepleegd.

Algemene instructies voor opslag en gebruik

Qboard® basiq bouw- en tegelementen moeten ongeacht de dikte, altijd liggend worden opgeslagen. Ze moeten worden beschermd tegen direct zonlicht, regen en vocht. Een verwerking met oplosmiddelhoudende stoffen moet worden vermeden.

Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet over voldoende draagvermogen beschikken. Mortelresten en andere verontreinigingen moeten worden verwijderd vóór met de verwerking van de Qboard® basiq bouw- en tegelementen wordt begonnen. Indien nodig dient het oppervlak met een speciale hechtprimer te worden behandeld. Nieuw aangemaakte ondergronden moetenvoldoende uitgedroogd zijn.

B Verwerking

B.1 Verwerking op een egale en niet-hechtende ondergrond

Is wegens afsluitende oppervlakken, scheidingslagen enz. een duurzame verlijming van Qboard® basiq aan de ondergrond niet gegarandeerd, dan moet Qboard® basiq over het gehele oppervlak vastgeplakt en aanvullend met slagpennen bevestigd worden. De verlijming en wapening van Qboard® basiq dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven voor een hechtende ondergrond. Na de volledige uitharding van de dunbedmortel en vóór de wapening van de voegen is aanvullend een bevestiging van Qboard® basiq met pennen noodzakelijk.

Als slagpennen dienen slagpennen van metaal (bijv. q metalen slagpennen) te worden gebruikt. Het aantal en de plaatsing van de bevestigingspunten dient uit afb. B.1.10 te worden overgenomen. De minimale inslagdiepte van de pennen in de dragende ondergrond dient bij 50 mm lange pennen 35 mm te bedragen. Vanaf een penlengte van 80 mm dient een minimale inslagdiepte van 50 mm te worden aangehouden.

De voegen tussen de bouw- en tegelementen moeten worden geplamuurd met behulp van Qboard® wapeningsband (of gelijkwaardig) en tegellijm. In natte ruimtes moeten de plaatvoegen en doorvoeren afgedicht worden. Voor het afdichten kan de Qboard® afdichtingsset 2-k (of gelijkwaardig) of het lijm- en afdichtmiddel BOARD-FIX® (of gelijkwaardig) worden gebruikt. Voor het overbruggen van scheuren bij de afdichting met BOARD-FIX® is ook JACKOBOARD®-wapeningsband nodig.

Meer informatie vindt u onder punt E.

B.2 Verwerking op een oneffen ondergrond

Is vanwege oneffenheden geen volledig dekkende verlijming op de ondergrond mogelijk, dan worden de Qboard® basiq bouw- en tegelementen slechts op verschillende punten bevestigd. Hiervoor kan Qboard® basiq vanaf een minimale dikte van 20 mm worden gebruikt. Qboard® basiq met een dikte van 4 en 6 mm is alleen voor volledig dekkende verlijming geschikt, niet voor puntsgewijze verlijming of voor montage op een raamwerk.

De mortelklompen worden puntsgewijs op Qboard® basiq aangebracht, waarbij de dikte van de aan te brengen mortelklompen afhankelijk is van de betreffende situatie. Het aantal en de plaatsing van de bevestigingspunten dient uit afb. B.2.10 te worden overgenomen. Als lijm kan normale mortel (bijv. kunststofgemodificeerde cementlijm) worden gebruikt. Om een snel werkproces te garanderen, wordt het gebruik van sneldrogende lijmsorten aanbevolen.

Het aanbrengen van Qboard® basiq op een wand gebeurt door licht aankloppen met een rubberen hamer, waarbij het bouw- en tegelement zodanig moet worden uitgelijnd, dat een egale, loodrechte en één lijn vormende ondergrond ontstaat, die met een dunbed kan worden betegeld. De grootte van de lijmklompen dient zo te worden gekozen, dat na het aankloppen met de rubberen hamer, de afstand tussen de Qboard® basiq bouw- en tegelementen en de ondergrond voor zover mogelijk maximaal 10 mm bedraagt. Bij grotere afstanden dient de tussenruimte te worden opgevuld met reststukken van het Qboard® basiq bouw- en tegelement. Na de volledige uitharding van de mortelklompen dient Qboard® basiq aanvullend met pennen te worden bevestigd.

Hiervoor moeten slagpennen van metaal (bijv. q metalen slagpennen) worden gebruikt. De bevestiging van Qboard® basiq met pennen dient exact door de mortelklompen in de wand te worden uitgevoerd. Daarom is het zinvol om op het Qboard® basiq bouw- en tegelement vooraf de plaatsen te markeren waar later de lijmklompen worden aangebracht. De minimale inslagdiepte van de pennen in de dragende ondergrond dient bij 50 mm lange pennen 35 mm te bedragen. Vanaf een penlengte van 80 mm dient een minimale inslagdiepte van 50 mm te worden aangehouden.

Het wapenen of afdichten van de voegen tussen de Qboard® bouw- en tegelementen moet worden uitgevoerd zoals beschreven onder B.1.

B.3 Verwerking op een egale en hechtende ondergrond

Op een egale en volledig hechtende ondergrond kan Qboard® basiq met een volledig dekkende lijmlaag worden aangebracht, zonder aanvullende penverbindingen. De ondergrond moet loodrecht zijn en één rechte lijn vormen. Er mogen zeker geen scheidingslagen (bijv. oude verfresten) aanwezig zijn, die een goede verbinding van de lijm met de ondergrond (bijv. pleisterlaag) verhinderen. De dunbedmortel (bijv. gewone kunststofgemodificeerde cementlijm) wordt met een grof getande spaan op de wand aangebracht. Vervolgens worden de Qboard® basiq bouw- en tegelementen, die eventueel eerst op maat zijn afgezaagd, door licht heen en weer schuiven volledig in de dunbedmortel ingebed. Indien nodig is afhankelijk van de benodigde lijmdikte, die op grond van lichte maattoleranties van de ondergrond verschillend kan zijn, een uitlijning van Qboard® basiq noodzakelijk, om een egale, loodrechte en één lijn vormende ondergrond te verkrijgen, die geschikt is voor betegeling in een dunbed.

Het wapenen of afdichten van de voegen tussen de Qboard® bouw- en tegelementen moet worden uitgevoerd zoals beschreven onder B.1.

B.4 Verwerking op regelwerk

Voor de montage van Qboard® basiq op een bestaande ondergrond met voldoende draagkracht kan een loodrechte en één lijn vormende houten onderconstructie worden aangebracht. Daarbij mag de maximale hart-op-hartafstand de 0,6 m niet overschrijden. Voor het bekleden van het houten regelwerk moet Qboard® basiq met een dikte van ten minste 20 mm worden gebruikt. Bij een verkleining van de latafstand tot 0,3 m is Qboard® basiq vanaf 10 mm dikte bruikbaar. Qboard® basiq met een dikte van 4 en 6 mm is alleen voor volledig dekkende verlijming geschikt, niet voor puntsge-

wijze verlijming of voor montage op een raamwerk. Voor de bevestiging aan de houtconstructie worden gewone universele schroeven en isolatierozetten (bijv. q-rozetten) gebruikt, waarbij de isolatierozetten gelijkliggend met het oppervlak van de bouw- en tegelementen worden verzonken. Het aantal en de plaatsing van de bevestigingspunten dient uit afb. B.4.6 resp. B.4.7 te worden overgenomen.

Voor de montage van Qboard® basiq op een regelwerk, bijv. als niet-dragende scheidingswand, is het aan te bevelen om te werken met een gewoon metalen regelwerk, waarbij de hart-op-hartafstand tussen de latten die op de vloer staan, afhankelijk van de lengte van de Qboard® basiq bouw- en tegelementen, 60 tot 65 cm moet bedragen. Qboard® basiq (minimale dikte 20 mm, afhankelijk van de op te lossen situatie) moeten parallel met het vloer- of plafondverloop met behulp van gewone, zelftappende plaatschroeven en isolatierozetten (bijv. q-rozetten) aan het metalen regelwerk worden bevestigd. Bij een halvering van de latafstand tot ca. 30 cm kan Qboard® basiq vanaf 10 mm dikte worden gebruikt. Het aantal en de plaatsing van de bevestigingspunten dient uit afb. B.4.6 resp. B.4.7 te worden overgenomen.

Bij de montage van zware voorwerpen dient erop te worden gelet dat de bevestiging niet in de schuimkern van Qboard® basiq wordt aangebracht, maar in de wand erachter of in het installatieraamwerk. Bij de montage van Qboard® basiq op een houten of metalen regelwerk of bij een puntsgewijze verlijming dient hier eveneens rekening mee te worden gehouden.

Het regelwerk moet indien nodig speciaal hiervoor worden aangevuld. Lichtere voorwerpen kunnen met behulp van spiraalpluggen worden bevestigd. Meer voorbeelden voor de bevestiging van voorwerpen vindt u op pagina 11.

Het wapenen of afdichten van de voegen tussen de Qboard® bouw- en tegelementen moet worden uitgevoerd zoals beschreven onder B.1.

B.5 Verwerking als scheidingswand

Voor de constructie van vrijstaande, niet-dragende scheidingswanden met Qboard® basiq bedraagt de minimale dikte 50 mm. Wanddieptes tot 1200 mm zijn constructief mogelijk zonder extra versterkingen van de uitkragende hoek. Ter garantie van de totale diepte van 1200 mm kunnen ook twee 600 mm brede Qboard® basiq bouw- en tegelementen aan elkaar worden verlijmd. De bevestiging van de vrijstaande wand wordt uitgevoerd met de lijm Board-Fix en met geschikte U- en H-profielen (bijv. Qboard® U- en H-profiel).

F Uitleg

De volledige ondergrond moet hiervoor voldoende draagvermogen hebben; eventuele mortelresten en verontreinigingen moeten eerst worden verwijderd. Meer informatie hierover vindt u op pagina 8.

Het wapenen of afdichten van de voegen tussen de bouw- en tegelementen moet worden uitgevoerd zoals beschreven onder B.1. Van een wapening van de voegen kan eventueel worden afgezien met het oog op visuele aspecten, zoals de bevestiging van de vrijstaande wand aan betegelde vlakken.

Om voldoende stabiliteit te garanderen, dient minstens één zijde van het bouw- en tegelement na de montage te worden betegeld. Om visuele redenen en om een voldoende puntbelasting te garanderen, dient de andere zijde van een geschikte pleisterlaag te worden voorzien.

D Betegelen/bepleisteren

D.1 Instructies voor het plaatsen van tegels en platen op Qboard® basiq

De tegels kunnen direct op het bouw- en tegelement worden gelijmd met tegel- of flexibele lijm van de klasse C2 (volgens EN 12004). De voegen tussen wand- en vloerbedekking en de hoekvoegen van de wandbedekking moeten als bewegingsvoegen worden uitgevoerd. De verlijming van de tegels kan met een normale dunbedmortel gebeuren (bijv. kunststofgemodificeerde cementlijm).

D.2 Instructies voor het bepleisteren van Qboard® basiq

Het bepleisteren van Qboard® basiq gebeurt door het inbedden van een extra, volledig dekkend wapeningsweefsel in het bovenste derde van de pleisterlaag. De pleisterlaag moet ten minste 3 mm dik zijn en mag een dikte van 15 mm niet overschrijden. Als pleister is o.a. cementpleister, kalk-cementpleister of kalkpleister geschikt. Bij het gebruik van gipspleister moet vóór het bepleisteren een geschikt voorstrijkmiddel op het bouw- en tegelement worden aangebracht. De verwerkingsinstructies van de betreffende pleisterfabrikant moeten in acht worden genomen.

E Verwerkingsvoorschriften voor Qboard® basiq bij gebruik als plaatvormig afdichtingssysteem in overeenstemming met de European Technical Assessment (ETA).

Het Qboard® basiq bouw- en tegelement kan worden gebruikt als een plaatvormig afdichtingssysteem voor het afdichten van muren en vloeren in natte ruimten. De geschiktheid hiervoor is bevestigd door de Europese technische beoordeling (ETA) en bijbehorende CE-markering. Voor deze toepassing gelden speciale richtlijnen, die hieronder beschreven zijn.

E.1 Afdichting van de plaatvoegen

Het bouw- en tegelement kan zoals hierboven beschreven in de wandconstructie worden verwerkt. De stootvoegen van het element moeten altijd worden afgedicht. De afdichting kan worden uitgevoerd met de tot de bouwkit behorende lijm- en afdichtingskit BOARDFIX® of met de 2-componenten Qboard®-afdichtingsset.

Variant 1: afdichten met BOARD-FIX®

Bij afdichting met BOARD-FIX® wordt op de langs- of Dwarszijde van de Qboard® basiq-bouwplaat BOARD-FIX® uit de cartridge rupsvormig aangebracht. De twee bouw- en tegel-elementen worden stevig tegen elkaar gedrukt, zodat overtollig materiaal kan worden gladgestreken. De lijm moet dekkend worden aangebracht, zodat met name op plaatsen waar voegen elkaar kunnen kruisen, bijv. aan overgangen tussen vloer en wand, geen gebrekkige verbindingen ontstaan. Er wordt schuim op schuim gelijmd. In hoeken kan het eventueel nodig zijn om op de te verbinden delen de mortel van het bouw- en tegelement te verwijderen. Aansluitend worden alle voegen tussen de elementen met Qboard® wapeningsband en een van de in de ETA aangegeven tegellijmen afgedicht en geplamuurd.

Variant 2: afdichten met Qboard® afdichtingsset 2-k

Als alternatief voor BOARD-FIX® kan de afdichting ook worden uitgevoerd met de Qboard® afdichtingsset 2-k. In dit geval moet de verwerkingsinstructie 'Qboard® afdichtingsset 2-k' worden gevolgd.

E.2 Afdichting van leidingdoorvoeren

Variant 1: afdichten met BOARD-FIX® en afdichtingsmanchet

Eerst wordt op de voeg tussen de buisleiding en het bouw- en tegelement BOARD-FIX® aangebracht. Vervolgens wordt een passende afdichtingsmanchet op de buis geschoven en over het hele oppervlak met BOARD-FIX® op het bouw- en tegelement vastgelijmd.

Variant 2: Afdichten met Qboard® afdichtingsset 2-k en afdichtingsmanchet

Hiervoor wordt de passende afdichtingsmanchet op de buis geschoven en over het hele oppervlak met 2-k afdichtingsmassa op het bouw- en tegelement vastgelijmd. Aansluitend wordt een tweede Applicatie van de 2-componenten afdichtingsspecie op de bovenkant van de afdichtingsmanchet en in de overgang naar het bouwplaatoppervlak aangebracht.

E.3 Afdichting van schroef- en plugbevestigingen

Variant 1: afdichten met BOARD-FIX®

Het bouwplaatoppervlak wordt met BOARD-FIX® in het volledige gedeelte van de isolatierozet of metalen plug afgekit

Variante 2: afdichten met Qboard afdichtingsset 2-k

Aan de metalen slagpen of isolatierozet wordt een stuk afdichtingsband met 2-k afdichtingsmassa vastgelijmd. Aansluitend wordt een tweede De 2-componenten afdichtingsspecie wordt aan op de bovenkant van de afdichtingstape aangebracht.

E.4 Reparatie

Schade aan het oppervlak van het bouw- en tegelement of douche-element kan worden gerepareerd met BOARD-FIX® of met de afdichtingsset 2-k. Hierbij wordt het beschadigde deel van het element opgevuld met BOARD-FIX® of de 2-k afdichtingsmassa van de afdichtingsset 2-k en gelijk met het oppervlak gladgestreken. In combinatie met de 2-k afdichtingsmassa wordt ook een stuk afdichtingsband met 2-k afdichtingsmassa in het beschadigde deel gelijmd. Aansluitend wordt een tweede Breng de 2-componenten afdichtingsspecie aan op de bovenkant van de afdichtingstape en in de overgang naar het bouwplaatoppervlak.

E.5 Betegelen

Wanneer de hierboven beschreven afdichtingen zijn uitgehard, kunnen de bouw- en tegelementen worden betegeld. Hierbij kunnen de tegels direct op de elementen worden gelijmd, zonder verdere voorbehandeling. Alleen de tegellijmen die in de ETA zijn vermeld, mogen worden gebruikt.

Verwerkingsinstructies Qboard® basiq Wandtoepassing

Belangrijk

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

Qboard® is een geregistreerd handelsmerk van Jackon Insulation GmbH – Fouten en veranderingen voorbehouden.
JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen • Telefoon +49 5204 9955-320 • Telefax +49 5204 9955-300
info@myqboard.com • www.myqboard.com